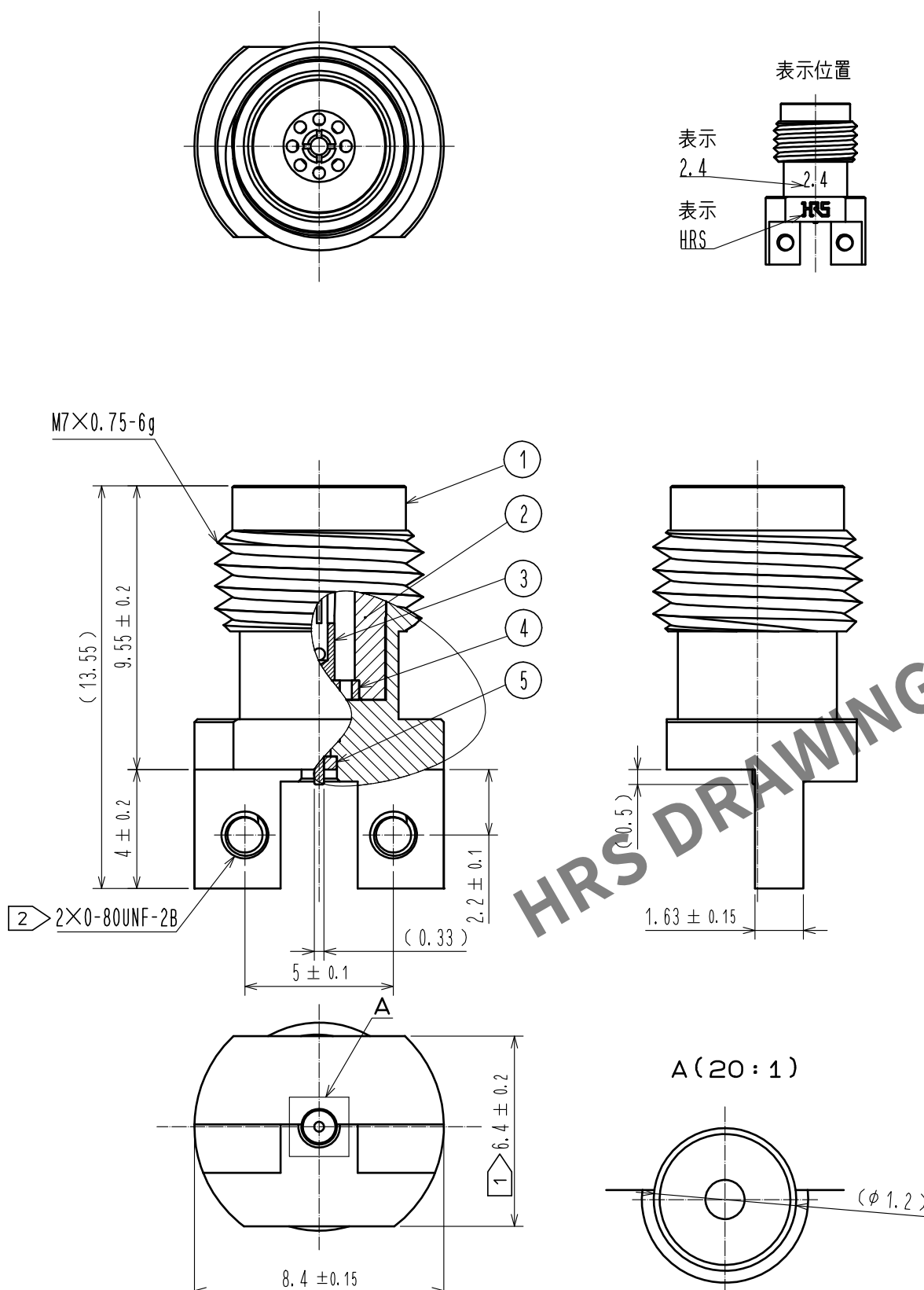
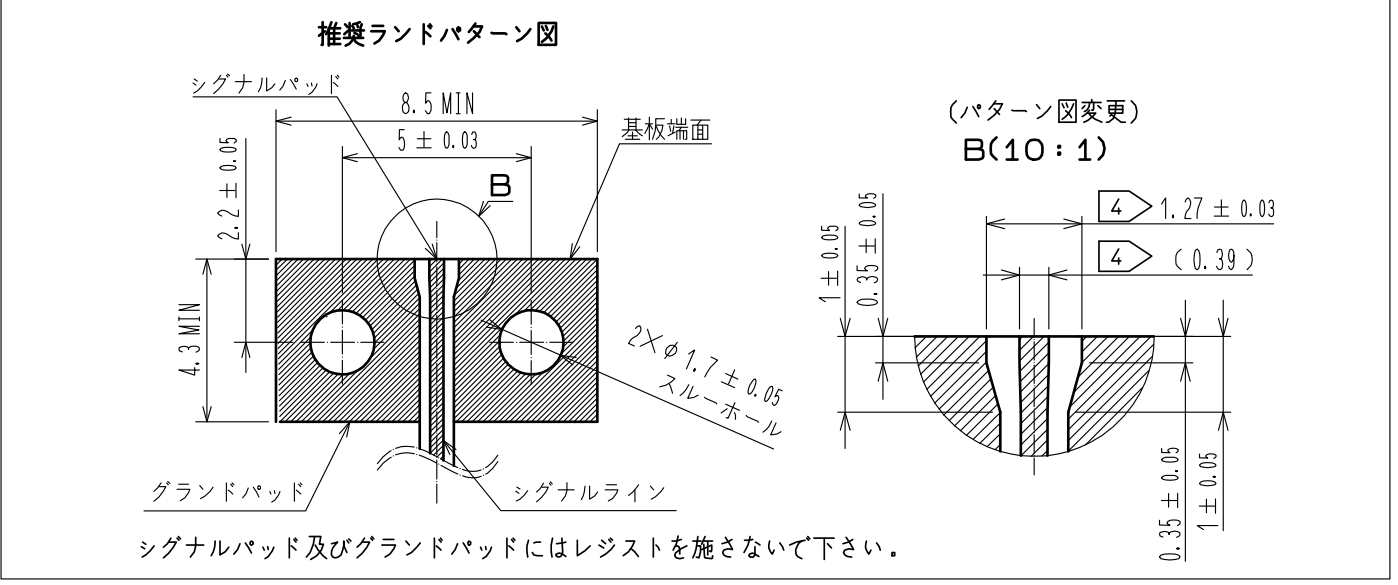
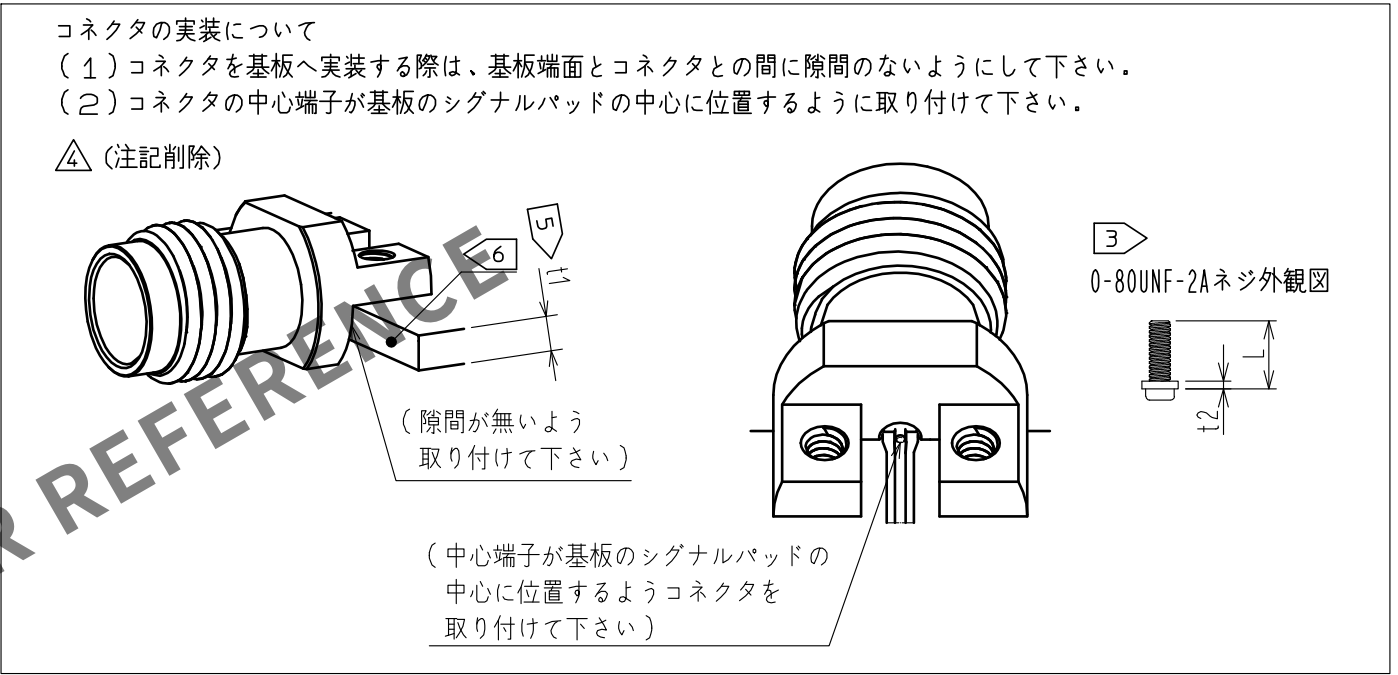
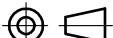


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1 かん合を行う際は、基板実装部へのトルクによる負荷をかけないよう、6.4±0.2フリス部をスパナ等で保持して下さい。
- 2 0-80UNF-2Bねじの推奨締め付けトルクは0.09N・mとなります。片側ずつ交互均等に締めていき、最後に両側増し締めして下さい。
- 3 コネクタ取付に使用するねじの長さLは、基板厚さt1(mm)+座金厚さt2(mm)+1.8mmのものをご使用下さい。
- 4 図示する寸法は誘電率3.35の基材、厚みt=0.2の場合の条件です。ランドパターン形状は基材の誘電率、板厚、層構成に依存します。コネクタを含めたPCBレイアウトの高周波解析を推奨します。
- 5 推奨基板厚t1=1.0mm以上です。
- 6 基板端面はサイドめっき処理を推奨します。
7. 高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。



2	ステンレス鋼	バッシベイト	5	PEI樹脂			
1	黄銅	ニッケルめっき	4	PEI樹脂			
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT  2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00016641	DESIGNED TS. KANEKO	CHECKED TS. NAKAGAWA	DATE 20230824
		APPROVED : KY. SHIMIZU	20160307	DRAWING NO. ADC-368795-00-00			
		CHECKED : KY. SHIMIZU	20160307	PART NO. H2. 4-LR-SR2			
		DESIGNED : TP. MATSUMOTO	20160307	CODE NO. CL0338-0603-0-00			
		DRAWN : TP. MATSUMOTO	20160307	 1 / 1			